

半导体产业新闻半月刊（精华版）

2019/0812-2019/0825



专题分类



并购投资

- 重点：
- ①江丰电子拟收购溅射靶材同行Silverac Stella。
 - ②敦南科技将出售其所有股份，美企Diodes接盘。
 - ③格芯出售光掩膜业务和工厂给日本公司Toppan。
 - ④中微拟对上海睿励投资1375万元，占股10.41%。



领域	时间	事件	原因/内容	资金(美元)
IC材料	2019/08/17	江丰电子拟收购 Silverac Stella 100% 股权	优化产品结构。 江丰在原有的产品基础上丰富了靶材产品类型，优化了产品结构，完善了业务布局，提高了公司抗风险能力。	
IC制造	2019/08/16	Diodes将收购敦南科技	业务增强。 将扩大Diodes在亚洲的离散业务，补充Diodes现有的产品线，特别是对成本敏感的应用。	4.2亿
IC制造	2019/08/16	格芯出售光掩膜业务	削减成本。 格芯此出售光掩膜业务是其进一步削减成本的动作，这部分业务是格芯收购的IBM德国德累斯顿晶圆厂的遗产。	
IC装备	2019/08/22	中微半导体拟投资上海睿励科学仪器，占股10.41%。	业务拓展。 中微布局集成电路工艺检测设备领域。	0.0194亿
存储器	2019/08/17	东芝将收购台湾光宝科技的存储业务部门	业务改善。 希望通过此次收购改善其上市前的业务结构。	
智能音频	2019/08/17	汇顶科技收购恩智浦 VAS业务	业务拓展。 此次收购是汇顶科技未来产业布局中的战略性一步，对于恩智浦音频部门的加入，这将拓宽其现有智能终端和IoT产品线的应用广度，增强在智能穿戴设备等智能音频应用领域的研发能力。	1.65亿
汽车软件	2019/08/17	新思科技收购QTronic GmbH	业务增强。 这项收购完成后将扩大新思科技的汽车解决方案产品组合，满足汽车一级供应商和OEM公司的需求。	



本土产业

- 重点：
- ①3年投资200亿元，澳门联合中科院全力打造大湾区集成电路技术创新中心。
 - ②华为与北大荒集团联手，加速智慧农业落地。
 - ③杭州集成电路产业园正式启动。
 - ④多个半导体项目落户南京、合肥、青岛、厦门等地。



【澳门联合中科院全力打造大湾区集成电路技术创新中心】

SIIP CHINA
SEMI产业创新投资平台

近日，中国科学院集成电路创新（澳门）研究院启动仪式在澳门举行，将联合豆萁国际投资集团（澳门）控股有限公司、合芯科技有限公司共同成立澳门豆萁集成电路制造有限公司，承接“大湾区国家集成电路技术创新中心”，计划在3年内总投资200亿元，带动我国集成电路技术创新和系统性知识产权布局。

【江丰电子与台湾新鹤达成合作】

7月26日，宁波江丰电子和台湾新鹤在宁波余姚举行签约仪式，正式宣布就半导体集成电路制造装备及核心部件项目进行战略合作。双方就台湾新鹤产品在中国大陆的独家经销权，及设立合资公司，技术引进，共同研发，生产，销售集成电路制造装备及核心部件等方面达成共识。

【杭州集成电路产业园正式启动】

在8月22日举行的2019全球闪存峰会上，杭州集成电路产业园正式启动。园区主要包括国产集成电路芯片设计，电脑硬盘，大数据磁盘阵列三大产业，同时将重点引入国家省市重点企业研究院，实验室及高校产学研研究中心。目前已经集聚了包括华澜微，鼎龙控股，钜联半导体在内的相关产业龙头企业。



【北大荒集团与华为签署战略合作协议】

8月20日，北大荒集团与华为签署战略合作协议。双方将利用自身资源和行业优势优先为对方提供全方位的支持服务，秉承优势互补、资源共享的原则，共同建立战略合作伙伴关系，在华为云建设、平安垦区、智慧农业、人才培养等多领域开展深入合作，联合探索打造新的业务发展模式，全面推进北大荒集团数字化转型。

【智能机器人及系统控制研究院落户南京】

近日，南京麒麟科技创新园与上海交通大学“系统控制与信息处理教育部重点实验室”签订合作协议，将共建南京智能机器人及系统控制研究院，重点围绕智能机器人、物联网、系统控制等领域进行产业化布局。

【南京江宁签约深兰科技等多个项目】

8月17日，南京江宁开发区高新园举办了科创项目集中签约、发照等活动，现场共签约24个科技产业项目及10个新型研发机构项目，总投资额超110亿元。此次集中签约的项目涉及智能网联汽车、智能制造、集成电路、人工智能、大数据等前沿科技领域。

【三利谱拟投建2500mm超宽幅TFT偏光片产线】

8月19日，三利谱发布公告称，公司与合肥签署了《三利谱合肥超宽幅2500mmTFT-LCD用偏光片生产线项目投资框架协议》。公司有意在安徽省合肥市投资建设一条2500mm超宽幅TFT偏光片生产线，产线设计年产能为3000万平米，主要生产及销售大尺寸液晶面板用偏光片。



【台湾再生晶圆和IGBT项目落户东海】

8月14日，江苏东海经济开发区与台湾合劲半导体科技有限公司举行了项目签约仪式。台湾合劲半导体科技有限公司将在东海经济开发区投资兴建“再生晶圆和IGBT”项目。该项目总投资7500万美元，达产后可年产8-12寸再生晶圆150万片，实现年销售收入5亿元。

【中韩合资12英寸半导体设备制造项目落地泰州】

8月14日，泰州高港区举办了高端半导体设备制造项目签约仪式。该项目由无锡乐东微电子（香港）有限公司和韩国APS公司共同投资，项目总投资3亿美元，注册资本1亿美元，计划用地约100亩，主要从事12英寸晶圆高端半导体设备制造和销售。

【多个先进制造项目在青岛开工】

8月9日，总投资235亿元的10个重点项目在位于青岛西海岸新区的青岛国际经济合作区集中开工，涉及新一代信息技术、新能源新材料、高端装备等领域。

【天马又一产线落户厦门】

近日，天马微电子与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门天马共同签署了《第6代柔性AMOLED生产线项目投资合作框架协议》。本项目预计投资480亿元，将在厦门建设第6代柔性AMOLED生产线（基板尺寸1500mm * 1850mm），设计产能为月加工柔性显示基板48千张。



市场数据

- 重点：
- ①全球闪存厂最新营收排名出炉：三星稳居第一，东芝第二。
 - ②上半年我国电子器件制造业增加值同比增长8.3%。
 - ③2018年全球EDA行业发展现状与发展前景：市场规模稳步提高，中国厂商加速追赶。
 - ④7月份北美半导体设备出货金额同比下降14.5%。



【Top15半导体厂商最新排名揭晓】

1H19 Top 15 Semiconductor Sales Leaders (\$M, Including Foundries)

1H19 Rank	1H18 Rank	Company	Headquarters	1Q19 Total IC	1Q19 Total O-S-D	1Q19 Total Semi	2Q19 Total IC	2Q19 Total O-S-D	2Q19 Total Semi	2Q19/1Q19 % Change	1H19 Total Semi	1H18 Total Semi	1H19/1H18 % Change
1	2	Intel	U.S.	15,799	0	15,799	16,239	0	16,239	3%	32,038	32,585	-2%
2	1	Samsung	South Korea	11,992	875	12,867	12,839	965	13,804	7%	26,671	39,785	-33%
3	4	TSMC (1)	Taiwan	7,096	0	7,096	7,749	0	7,749	9%	14,845	16,312	-9%
4	3	SK Hynix	South Korea	5,903	120	6,023	5,397	138	5,535	-8%	11,558	17,754	-35%
5	5	Micron	U.S.	5,465	0	5,465	4,710	0	4,710	-14%	10,175	15,478	-34%
6	6	Broadcom Inc. (2)	U.S.	3,764	419	4,183	3,739	424	4,163	0%	8,346	9,020	-7%
7	7	Qualcomm (2)	U.S.	3,722	0	3,722	3,567	0	3,567	-4%	7,289	7,984	-9%
8	9	TI	U.S.	3,199	208	3,407	3,264	213	3,477	2%	6,884	7,346	-6%
9	8	Toshiba/Toshiba Memory	Japan	2,724	320	3,044	2,339	260	2,599	-15%	5,643	7,717	-27%
10	10	Nvidia (2)	U.S.	2,215	0	2,215	2,459	0	2,459	11%	4,674	6,259	-25%
11	11	Infineon	Europe	1,352	901	2,253	1,358	906	2,264	0%	4,517	4,581	-1%
12	12	NXP	Europe	1,885	209	2,094	1,995	222	2,217	6%	4,311	4,559	-5%
13	13	ST	Europe	1,581	485	2,066	1,657	508	2,165	5%	4,231	4,464	-5%
14	19	Sony	Japan	192	1,554	1,746	210	1,889	2,099	20%	3,845	3,389	13%
15	16	MediaTek (2)	Taiwan	1,711	0	1,711	1,980	0	1,980	16%	3,691	3,728	-1%
—	—	Top-15 Total	—	68,600	5,091	73,691	69,502	5,525	75,027	2%	148,718	180,961	-18%

(1) Foundry (2) Fabless

Source: Company reports, IC Insights' Strategic Reviews database

IC Insights公布了全球前15家半导体（IC和OSD光电，传感器和分立器件）厂商的销售额排名：包括6家总部位于美国的供应商，3家位于欧洲，两家位于中国台湾，以及韩国和日本。



【前六大闪存厂最新营收排名出炉】

表、2019年第二季度全球NAND Flash品牌厂商营收排行 单位：百万美元

Company	Revenue		Market Share	
	2Q19	QoQ (%)	2Q19	1Q19
Samsung	3,765.7	16.6%	34.9%	29.9%
Toshiba	1,948.1	-10.6%	18.1%	20.2%
WDC	1,506.0	-6.5%	14.0%	14.9%
Micron	1,461.0	-17.7%	13.5%	16.5%
SK Hynix	1,106.6	8.1%	10.3%	9.5%
Intel	940.0	2.7%	8.7%	8.5%
Others	59.4	2.3%	0.6%	0.5%
Total	10,786.9	0.0%	100.0%	100.0%

注1：1Q19汇率均值：美元兑日圆汇率：1:110.2；美元兑韩国汇率：1:1,124.8

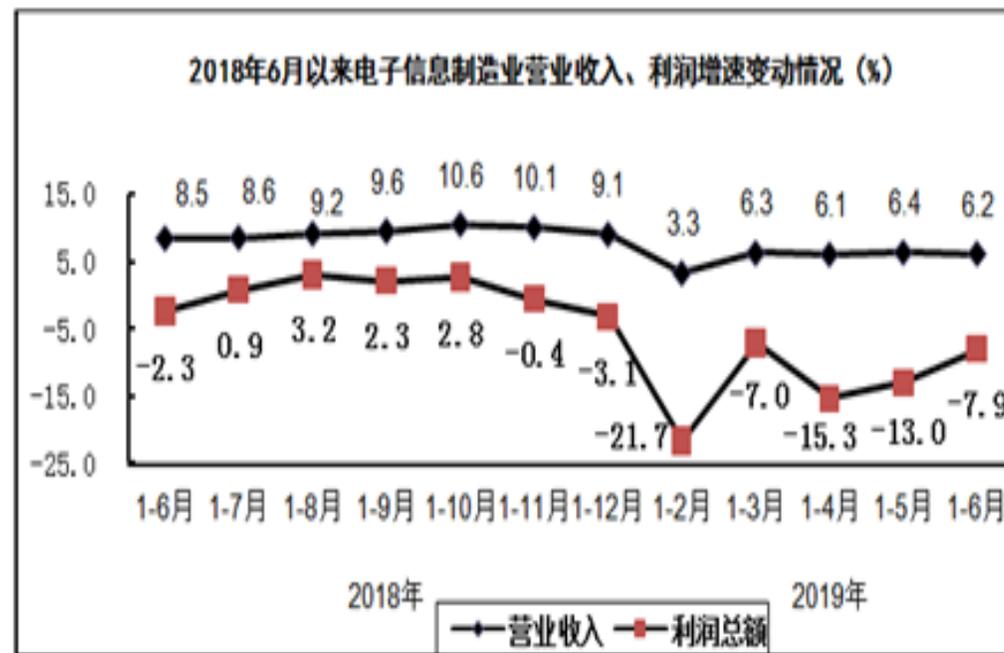
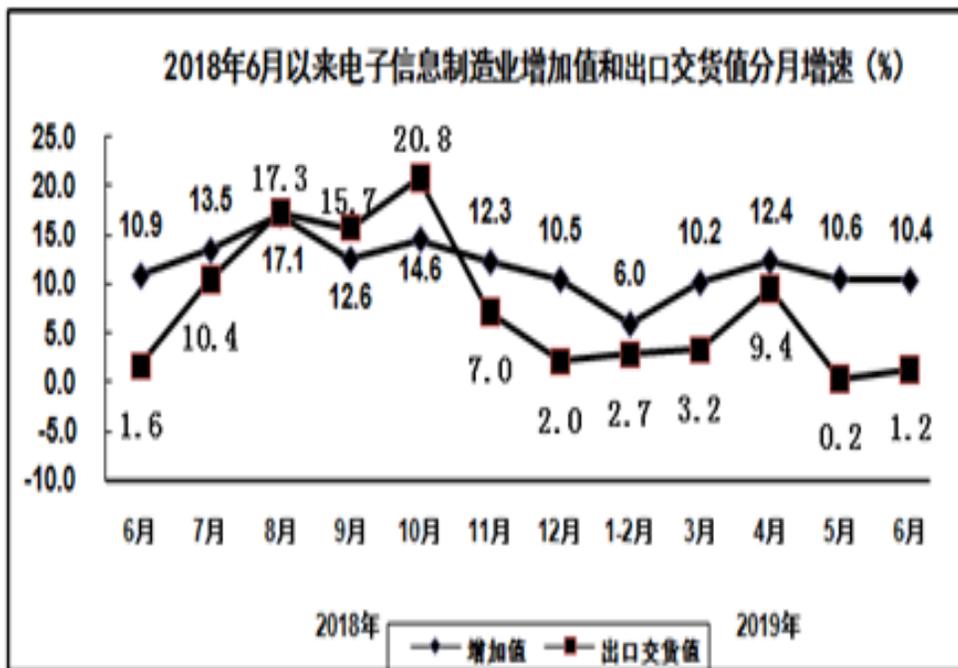
注2：2Q19汇率均值：美元兑日圆汇率：1:110.0；美元兑韩国汇率：1:1,166.1

数据来源：集邦咨询，2019年8月

DRAMeXchange调查，2019年第二季度NAND Flash整体产业营收仍维持在约108亿美元的水平，较第一季基本持平。



【上半年我国电子器件制造业增加值同比增长8.3%】

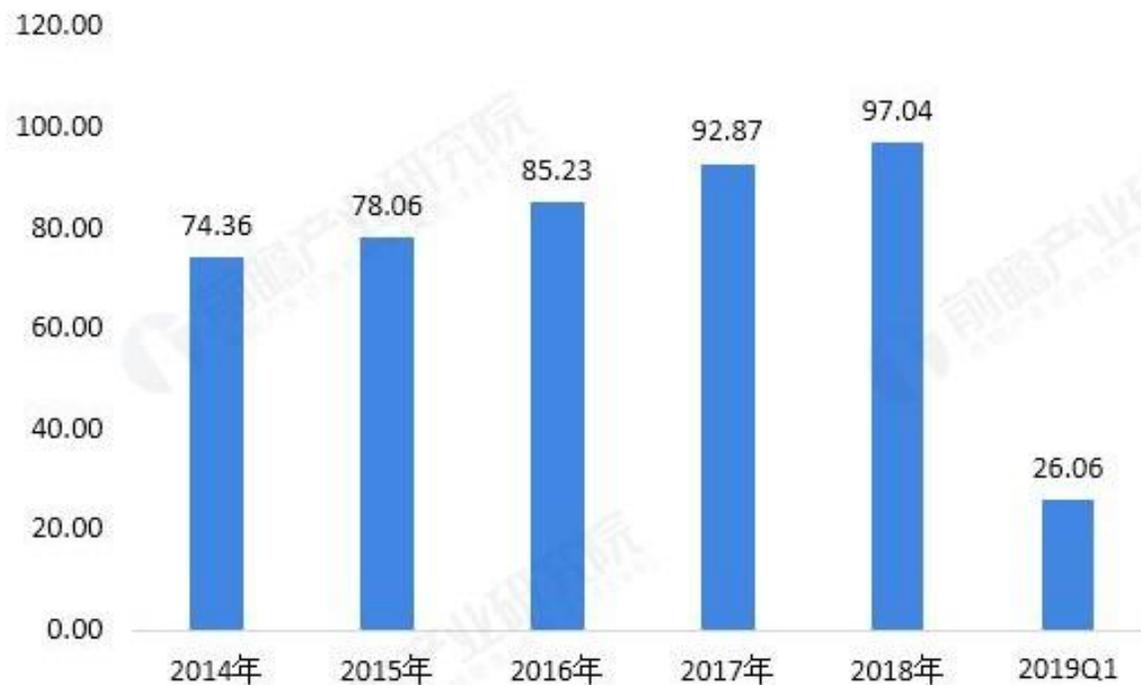


近日，工信部网站公布了2019年上半年电子信息制造业运行情况：总体来看，上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.6%，增速比去年同期回落2.8个百分点。规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长3.8%，增速同比回落2.3个百分点。



【2018年全球EDA行业发展现状与发展前景】

图表2：2014-2019年Q1全球EDA行业市场规模（单位：亿美元）



资料来源：ESD Alliance 前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

根据ESD Alliance数据显示，2018年全球EDA行业市场规模为97.04亿美元，较2017年同比增长4.49%。2019年第一季度行业收入为26.06亿美元，同比增长12.89%。



【国产EDA突围之路】

序号	公司	工具类别	人员规模 (人)
1	华大九天	模拟设计全流程系统工具、数字后端分析优化系统工具、生产制造点工具、平板显示设计全流程工具	~400
2	杭州广立微	成品率分析和测试工具	~70
3	济南概伦	器件建模服务、快速仿真工具	~50
4	苏州芯禾	芯片级系统仿真、集成无源器件IPD、系统级封装SiP 工具	~80
5	武汉九同方	射频仿真工具	~ 20
6	北京博达微	器件建模服务工具	~40
7	天津蓝海微	版图相关EDA工具	~10
8	苏州珂晶达	工艺参数仿真工具	~30
9	深圳鸿芯微纳	布局布线工具	~5
10	成都奥卡思微	形式验证工具	~10
11	杭州行芯	电压降分析及电磁场分析工具	~10

2018年国内EDA销售额大概5亿美元（约合33亿元），约占全球市场的8%，而国产EDA工具销售额3.4亿，占国内EDA市场10%。



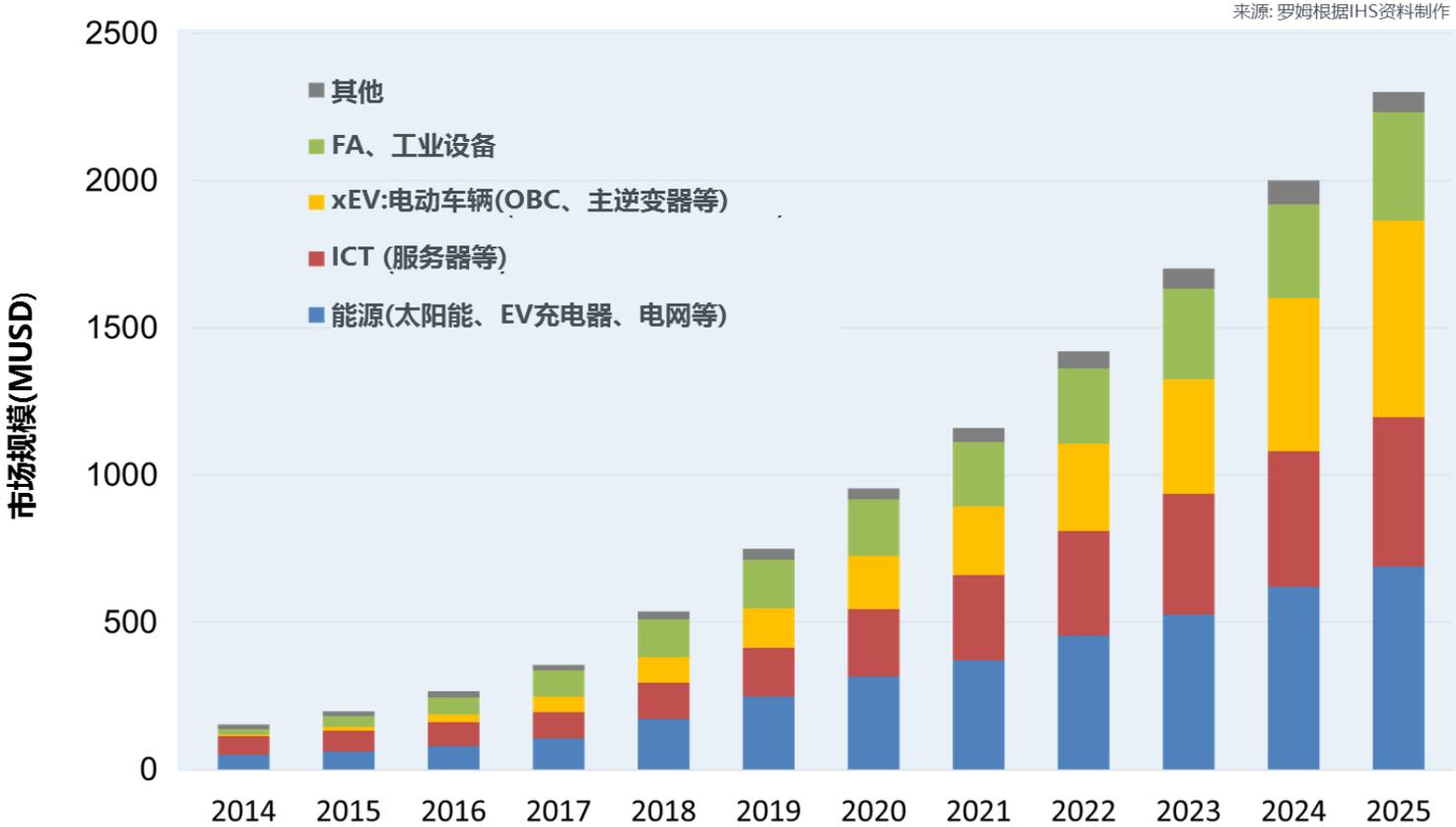
【北美半导体设备出货金额同比下降14.5%】



SEMI 公布7月北美半导体设备制造商出货金额20.34亿美元，同比下降14.5%。SEMI 预估，今年全球半导体设备市场规模恐下滑，不过台湾有晶圆代工龙头台积电领衔冲刺先进制程，有望超越南韩，成为全球最大设备销售市场。



【SiC将达23亿美元规模】



罗姆基于IHS的调查，保守地预测2025年SiC整个市场规模将达到约23亿美元。



焦点关注

- 重点：
- ① 中国对750亿美元商品加税，特朗普上调关税反击。
 - ② 三星、SK海力士危机缓解，日本第二次批准向韩国出口高科技材料。
 - ③ 韩国明年投4.7万亿韩元发展系统半导体、AI、5G等产业。



【中国对750亿美元商品加税，特朗普上调关税反击】

8月23日晚，中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征10%和5%关税，同时对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。作为反击，美国总统特朗普在推特上宣布，原定对价值3000亿和2500亿美元中国进口商品加征的关税上调。特朗普还向美国企业施压，要求它们撤出中国。对此人民日报表示：中方对美第三轮反制说到做到。

【三星、SK海力士危机缓解，日本第二次批准向韩国出口高科技材料】

据外媒报道，日本刚刚已批准向韩国出口一种高科技材料。这是自7月日本队韩国实施出口限制以来，日本第二次批准向韩国出口高科技材料。8月初，日本政府首次批准了向韩国出口的一批光刻胶。而此次日本政府批准向韩国出口的高科技材料仍是光刻胶，这对于三星电子、SK海力士等韩国厂商的芯片生产至关重要。

【韩国明年投4.7万亿韩元发展系统半导体、AI、5G等产业】

近日，据韩联社报道，韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，政府明年将共投入4.7万亿韩元（约合人民币276亿元）推动部分产业实现创新发展，并力促创新发展的覆盖面逐渐扩大至其他产业。他介绍，政府计划明年对数字、网络（5G）、人工智能投资1.7万亿韩元，对系统半导体、生物健康、未来汽车投资3万亿韩元。



设计制造

- 重点：
- ①格芯成功流片了基于ARM架构的高性能3D封装芯片。
 - ②兆易创新发布首款RISC-V内核32位通用MCU。
 - ③华为正式发布AI芯片“昇腾910”。
 - ④紫光年底量产64层堆栈3D闪存，美光量产第三代10nm级内存。



【格芯成功流片了基于ARM架构的高性能3D封装芯片】

近日，格芯宣布，携手ARM采用12nm FinFET工艺验证了3D设计测试（DFT）方法，可以在芯片上集成多种节点技术，优化逻辑电路、内存带宽和射频性能，可向用户提供更多差异化的解决方案。这意味着格芯亦投身于3D封装领域，将与英特尔、台积电等公司一道竞争异构计算时代的技术主动权。

【兆易创新发布首款RISC-V内核32位通用MCU】

8月22日，兆易创新正式发布了全球首个基于RISC-V开源架构内核的32位通用MCU产品——GD32VF103系列。兆易创新是首次将开源指令集架构RISC-V引入通用微控制器领域，并提供了从芯片到程序代码库、开发套件、设计方案等完整工具链支持并持续打造RISC-V开发生态。

【Xilinx推出全球最大FPGA】

8月22日，赛灵思公司宣布推出全球最大容量的FPGA-Virtex UltraScale+ VU19P，从而进一步扩展了旗下16纳米Virtex® UltraScale+™产品系列。

【华为正式发布AI芯片“昇腾910”】

8月23日，华为公司轮值董事长徐直军出席AI处理器“昇腾910”及全场景AI计算框架MindSpore发布会。实测结果表明，在算力方面“昇腾910”完全达到了设计规格，重要的是，达到规格算力所需功耗仅310W，明显低于设计规格的350W。



【SK海力士计划明年量产超高速DRAM】

SK海力士宣布开发出HBM2E DRAM，这是一种高带宽内存半导体，可用于人工智能（AI）设备和超级计算机。该公司表示，其新芯片具有业界最快的速度。HBM2E支持超过每秒460GB的带宽，基于每个引脚的3.6Gbps速度性能和1024个数据I/O，这比该公司一年前开发的HBM2 DRAM高出50%。

【台积电核准450亿元资本预算扩充先进制程产能】

近日，晶圆代工厂台积电召开了董事会。会上，公司董事会核准了资本预算约2009.093亿元（约合人民币450亿元），将用于兴建厂房，建置、扩充、升级先进与特殊制程产能，以及第四季研发资本预算与经常性资本预算。

【美光量产第三代10nm级内存】

日前美光宣布量产了12nm工艺的16Gb DDR4内存，这是第三代10nm级内存工艺。美光表示，与上一代1Ynm制程相比，12nm 16Gb DDR4内存芯片可以提供更高的密度、更高的性能及更低成本。

【紫光年底量产64层堆栈3D闪存】

据报道，紫光旗下的长江存储近年来大举投资存储芯片产业，其中NAND闪存是优先发展对象，目前已经形成了NAND闪存研发生产、主控IC以及后端封测等全产业链，预计今年年底量产64层堆栈的3D闪存，2020年则会生产128层堆栈3D闪存。



产业合作

- 重点：
- ①联发科与T-Mobile成功完成全球首次5G独立组网联网通话对接。
 - ②高通宣布与俄罗斯合作部署欧洲首个5G毫米波网络。
 - ③紫光展锐携手罗德与施瓦茨公司完成了5G OTA测试解决方案。
 - ④特斯拉已同意从LG化学采购电池，用于上海超级工厂。



领域	合作公司/单位	目的
5G	联发科、T-Mobile等	成功完成全球首次5G独立组网（SA）联网通话对接，是5G生态建设关键里程碑。
5G	高通、俄罗斯	高通支持今年秋季在莫斯科测试并部署欧洲首个5G毫米波网络。
5G	紫光展锐、罗德与施瓦茨	采用紫光展锐5G毫米波芯片和罗德与施瓦茨公司的5G OTA测试解决方案，双方将展开在N260等更高频段以及多频段的毫米波RFIC的研发与测试。
电动汽车	特斯拉、韩国LG化学	特斯拉将从韩国LG化学采购电池，用于在中国新工厂生产的电动汽车。



产品应用

- 重点：
- ① 阿里巴巴达摩院发布新一代AI语音FPGA芯片技术。
 - ② 寒武纪宣布将在2019世界人工智能大会上展示新一代云端AI芯片。
 - ③ 三星发布首款亿像素手机图像传感器。
 - ④ 芯视界首发全球领先单光子检测激光测距ToF芯片。



领域	公司/单位	产品及特性
控制器芯片	华澜微	成功开发了SAS-SATA控制器，这也是中国第一颗SAS控制器芯片。这也标志着华澜微从存储控制器到存储阵列控制器的快速发展。
AI芯片	阿里巴巴	阿里巴巴达摩院发布新一代AI语音FPGA芯片技术——Ouroboros，该技术能将语音生成算法的计算效率提高百倍以上。
AI芯片	寒武纪	将在8月29-31日的2019世界人工智能大会上，首次展示新一代云端AI芯片“思元270”。思元270的性能提升至上一代MLU100的4倍。
传感器	三星	发布了全球首款1.08亿像素的图像传感器——ISOCELL Bright HMX，该传感器与小米合作研发，将为移动相机带来创新。
传感器	Velodyne Lidar	推出了Puck 32MR™传感器，以满足自动驾驶行业的主要市场需求。
传感器	Vayyar	推出60和79GHz双频传感器方案，提升车内安全性并改善乘客监控。
探测器	大立	成功研制首款12 μ m像元600万像素非制冷红外焦平面探测器。
ToF芯片	新视界	发布全球领先的基于单光子检测的激光测距ToF芯片。该芯片在低成本CMOS工艺上实现了超高灵敏度、高分辨率单光子检测阵列，集成了自主研发的超高精度测距电路和抗干扰数字算法。
指纹识别芯片	思立微	推出最新一代的适用于OLED屏下光学指纹识别的CSM (chip-scale module)方案GSL7001F。相比上一代传统COB (chip on board) 方案，在模组尺寸 (XY方向) 极具优势，面积可缩减50%，将可为智能手机内部的电池、摄像头等内部器件提供更多的空间。
AR	Snapcha	推出Spectacles 3。这是一款经过重新设计的增强现实版太阳镜，采用时尚的全新设计，并增加了高清摄像头，以创造深度感。



大国重器

重点：①上海临港新片区正式揭牌，集成电路产业受益。



【上海临港新片区正式揭牌，集成电路产业受益】

- ① 8月20日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正式揭牌。在20日上午的新闻通气会上，上海市政府副秘书长、临港新片区常务副主任朱芝松表示，通过打造“三个最”，全力把新片区打造成中国全面深化改革开放的新引擎。三个“最”即打造最高水平对外开放的新高地、打造最能创新突破的改革开放试验田、打造最自由的开放型经济体系。
- ② 在“打造最自由的开放型经济体系”方面，集成电路等产业再次被重点提及，即上海新片区将聚焦人工智能、集成电路、生物医药、航空航天等“卡脖子”的重点产业，有力打造一批代表中国参与国际竞争的世界级产业集群。
- ③ 据悉，目前临港已聚集了40多家集成电路产业相关企业，临港也将依托新昇半导体国产大硅片项目和积塔半导体项目，集聚产业链上下游优质资源，打造上海集成电路新高地。

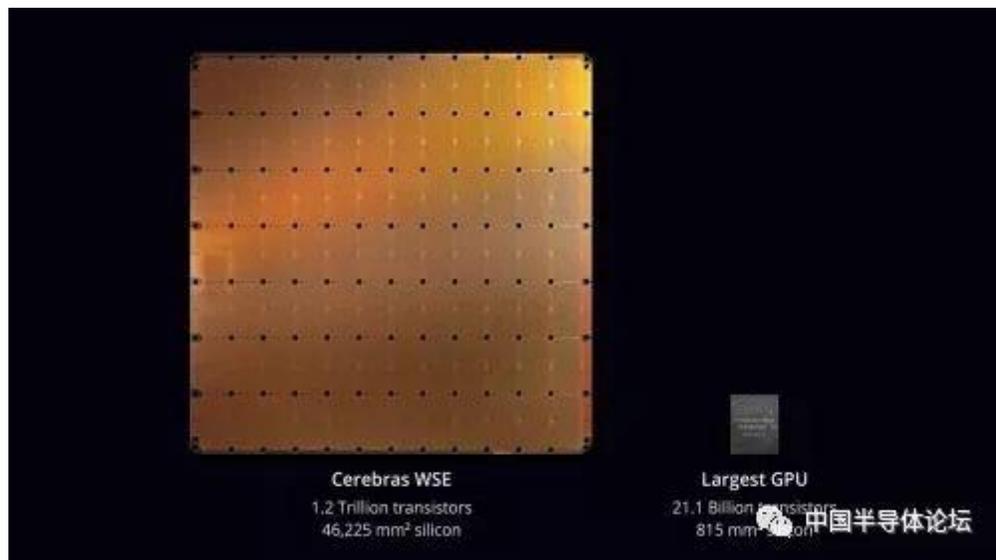


科技前沿

- 重点：
- ①世界最大芯片问世：1.2万亿晶体管，面积大过iPad。
 - ②新型三维互连技术让未来可穿戴电子产品变得更舒适实用。
 - ③科学家合成世界首个18个原子的纯碳环。



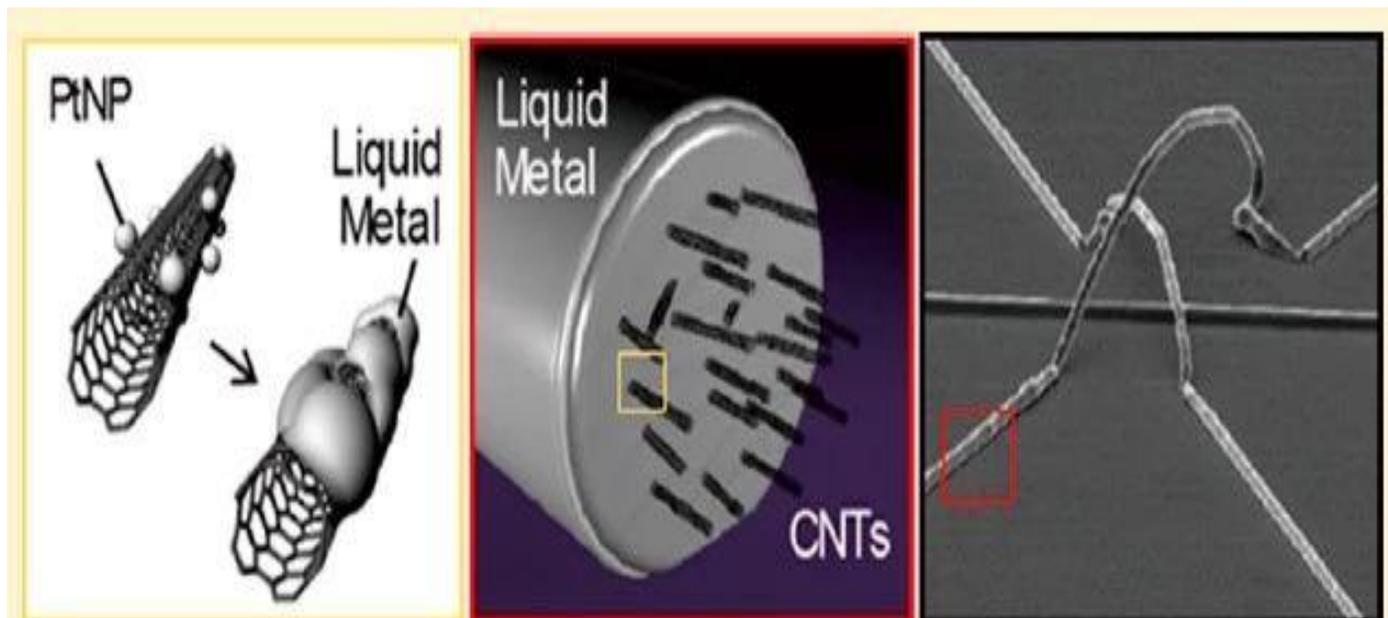
【史上最大芯片问世】



- ① 据外媒报道，美国加州的创业公司Cerebras发布了号称全球最大的芯片WSE，而且是专门为人工智能计算打造的。
- ② 这款芯片拥有1.2万亿个晶体管，其数量是英伟达最新一代旗舰GPU Titan V的57倍。这款虽然面积巨大（面积高达46,225平方毫米）但依然使用的是台积电16纳米制程工艺，其中包含400,000个核心，片上存储高达18G，功耗1.5万瓦（约等于6台电磁炉的功率），内存带宽9PB/秒，通信结构带宽100PB/秒。
- ③ 该公司表示，仅用一块这样的芯片即可驱动复杂的人工智能系统，从无人驾驶汽车到监控系统。



【新型三维互连技术让未来可穿戴电子产品变得更舒适实用】

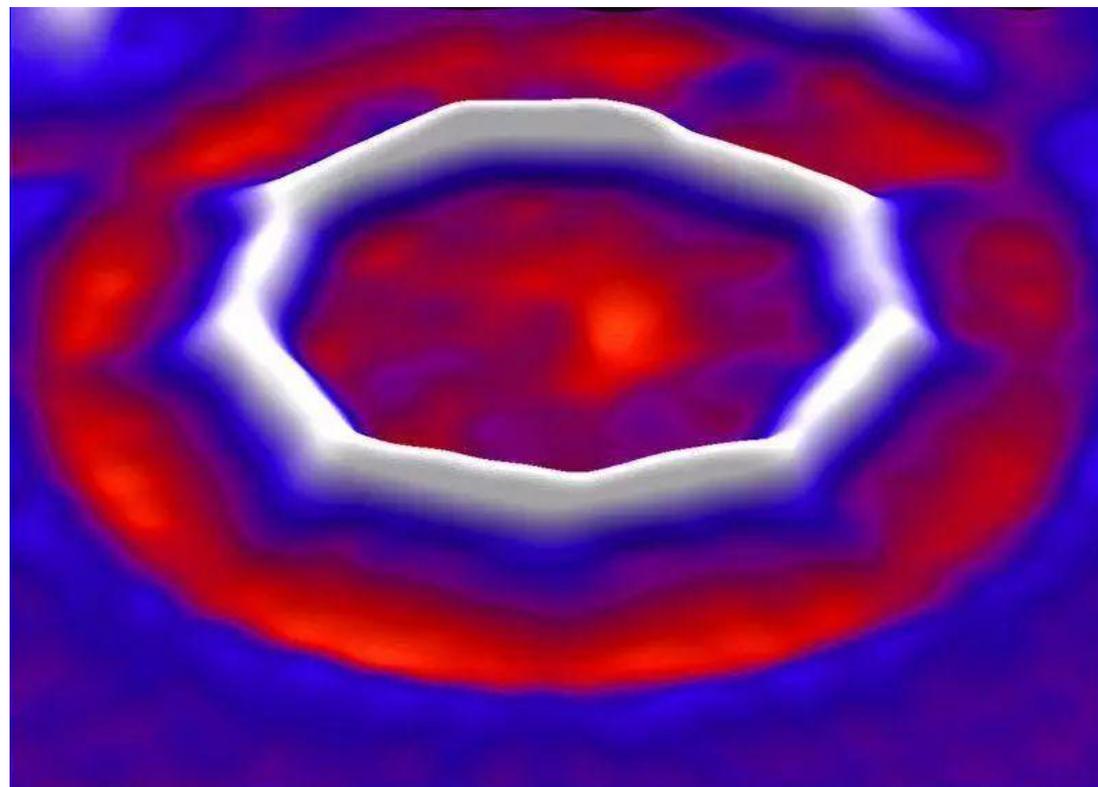


图：这项研究的图形概要。以铂（Pt）修饰的碳纳米管与液态金属之间具有很高的亲合性（左），并导致碳纳米管在液态金属中均匀分布，形成可拉伸的金属复合材料（中）。这种可拉伸的金属材料的机械性能优于未经处理的液态金属，因此很适合被塑造为“始终如一的细（也就是说高分辨率）”的三维结构（右）。

韩国基础科学研究院与蔚山国立科技大学研制出高导电率、可完全变形的超薄电极材料。这项研究通过更细的三维互连线，将帮助我们彻底革新智能装置的外观，并加强它们的技术功能。



【科学家合成世界首个18个原子的纯碳环】



8月15日，Sicence 发表了牛津大学化学系与IBM 苏黎世研究实验室合作的一项成果，他们合成了世界上第一个完全由碳原子构成的环状分子—C18，其中的18个碳原子通过交替的单键和叁键连接而成，早期研究发现C18环分子具有半导体特性，这意味着类似的碳直链结构可能可以成为分子级别的电子元件。



【5G刚来，华为已在加拿大启动6G研究】

据加拿大媒体报道，华为已经在加拿大渥太华启动了6G网络的研究，同时华为已经与加拿大多所大学的研究者展开了洽谈。华为加拿大研发策略与合作伙伴副总裁Song Zhang称：“5G已经很新，展望6G是所谓5G进化的一部分。”华为表示，其渥太华研发实验室将帮助引领华为全球6G发展。

【华为计划在俄罗斯建1500人研究中心】

据媒体报道，华为正在大幅扩张位于俄罗斯的研究中心，预计今年底招聘500多名员工，未来5年将增加到1500人，成为欧洲、北美之后第三大海外研发中心。

【将名字刻在硅芯片送往火星：已有23万中国人参与】

近日，NASA开启了一项特别活动，美国下一代火星车“火星2020”计划于2020年7月从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地41号航天发射中心发射。届时，“火星2020”将携带一枚刻有名字的硅芯片一同进行旅程。目前已有超过846万人报名参与将自己的名字刻到硅芯片上，跟随“火星2020”一起前往火星，其中中国有23万人。



人事变迁

重点：①李家杰辞任小米集团独立非执行董事，唐伟章接任。



【李家杰辞任小米集团独立非执行董事，唐伟章接任】

- ① 8月23日，小米集团发布公告表示，李家杰已辞任独立非执行董事、董事会提名委员会主席及企业管治委员会成员，自2019年8月23日生效。
- ② 未来，李家杰专注及投入更多时间履行恒基兆业地产有限公司主席兼董事总经理以及香港中华煤气有限公司主席等新职务。此外，唐伟章已获委任为独立非执行董事、董事会提名委员会主席及企业管治委员会成员，自2019年8月23日起生效。



专利要闻

重点：①智能手机、新型显示器领域火热，巨头纷纷申请新专利。



类别	公司/单位	事件内容
新专利	三星	新柔性屏翻盖机设计专利曝光。
新专利	三星	折叠屏新专利：Z字形折叠设计。
新专利	苹果	申请micro-LED显示器专利，用于iMac等。
新专利	LG	折叠屏新专利曝光：双折设计 对折之后继续折。
新专利	Xbox	新专利：可拆式手柄渲染图。
新专利	小米	可折叠手机专利：采用后置三摄。



SIIP CHINA

【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投资平台。



联系我们

SEMI中国 Lily Feng
Tel: +86-21-60278500
E-MAIL: lifeng@semi.org
<http://www.semi.org.cn/siip>

订阅半导体产业新闻半月刊（精华版）欢迎来信索取
(来信请附名片并注明公司名称、职务、联系电话)
SEMI中国 Lily Feng
E-MAIL: lifeng@semi.org

